

## 日月光一〇五年度第二季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 105 年 7 月 29 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇五年度第二季獲利報告，本公司一〇五年第二季之合併營業收入較一〇五年第一季成長 0.4%，較一〇四年同期下滑 11%，為新台幣 62,601 百萬元。茲將日月光一〇五年度第二季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

### 合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	105 年度 第二季	105 年度 第一季	104 年度 第二季	105 年度 上半年	104 年度 上半年
營業收入淨額	62,601	62,371	70,222	124,972	134,884
營業毛利	12,255	11,449	11,566	23,704	23,879
營業淨利（淨損）	5,931	5,206	5,409	11,137	11,701
稅前淨利（淨損）	6,473	5,656	5,400	12,129	10,906
所得稅利益（費用）	(1,523)	(1,318)	(1,596)	(2,841)	(2,452)
非控制權益	(271)	(175)	(152)	(446)	(333)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	4,679	4,163	3,652	8,842	8,121
基本每股盈餘(新台幣元)	0.61	0.54	0.48	1.16	1.06
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.51	0.43	0.43	0.94	1.02

### 綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	105 年度 第二季	105 年度 第一季	104 年度 第二季	105 年度 上半年	104 年度 上半年
營業收入淨額	38,504	35,543	37,671	74,047	76,276
營業毛利	9,561	7,832	9,504	17,393	19,499
營業淨利（淨損）	4,957	3,222	5,101	8,179	10,647
稅前淨利（淨損）	6,001	4,746	5,229	10,747	10,459
所得稅利益（費用）	(1,266)	(529)	(1,537)	(1,795)	(2,246)
非控制權益	(56)	(54)	(40)	(110)	(92)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	4,679	4,163	3,652	8,842	8,121

### 半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	52
電腦	12
汽車，消費性電子及其它	36
前十大客戶佔營收比重	51

封裝業務產品組合	%
Bumping, Flip Chip, WLP & SiP	31
IC Wirebonding	61
Discrete and Others	8
封裝資本支出金額	136 百萬美元
打線機台數	15,920 台

測試業務產品組合	%
後段測試	77
晶圓測試	20
前段測試	3
測試資本支出金額	107 百萬美元
測試機台數	3,629 台

### 電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	46
電腦	20
消費性電子	18
工業用	8
汽車電子	7
其它	1
前十大客戶佔營收比重	88
EMS 資本支出金額	4 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2016 年第三季的業績展望如下：

- 半導體封測事業產能將較前季增長百分之五
- 半導體封測事業利用率也將較前季提升百分之五
- 半導體封測事業毛利率與去年第四季水準相仿
- 電子代工服務生意量將會接近去年第二季水準
- 電子代工服務毛利率將會接近今年第一季水準